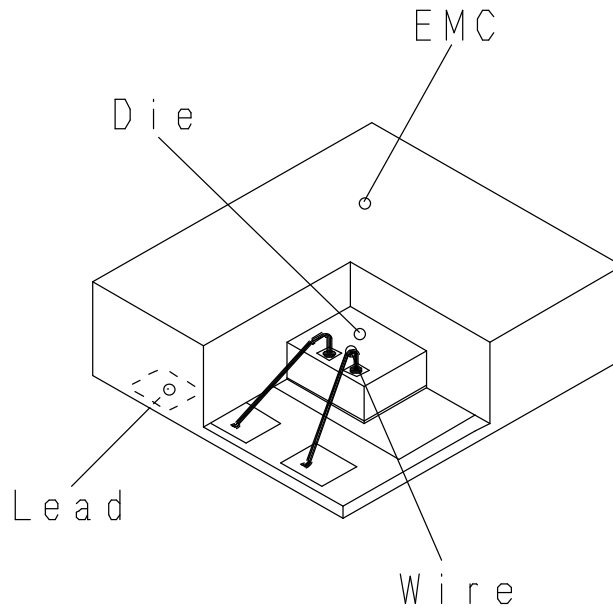


外形寸法図

PL packageシリーズ



お客様の御要望に合わせた多種仕様の御提供が可能です。

①チップに適した最適パッケージサイズ(Body Width/Length)の御提案が可能です。

②パッケージ厚(Body Thickness)は、0.38/0.58mmとも御用意出来ます。

③リード材質(Lead Material)は、非磁性体の御要望に応じてCu材での対応も可能です。

以下が現在の量産事例です。

Lead Count	Body Width	Body Length	Body Thickness	Stand-off	Lead Pitch	Lead Material	Die Face Up/Down
3(1212)	1.20	1.20	0.58	-	0.60	Ni	U
4(1010)	1.00	1.00	0.58	-	0.65	Ni	U
4(1216)	1.20	1.60	0.38/0.58	-	0.60	Ni	U
4(1421)	1.40	2.10	0.38	-	0.65	Cu	U
6(1616)	1.60	1.60	0.38/0.58	-	0.50	Ni	U
6(1619)	1.60	1.90	0.58	-	0.50	Ni	U
6(1820A)	1.80	2.00	0.58	-	0.50	Ni	U
6(1820C)	1.80	2.00	0.58	-	0.55	Ni	U
8(2020)	2.00	2.00	0.58	-	0.50	Ni	U
8(2030)	2.00	3.00	0.58	-	0.50	Ni	U
8(2725)	2.70	2.50	0.58	-	0.65	Ni	U
8(3030)	3.00	3.00	0.58	-	0.65	Ni	U
10(2725)	2.70	2.50	0.58	-	0.50	Ni	U
10(2527)	2.50	2.70	0.58	-	0.50	Ni	U
16(2525)	2.50	2.50	0.58	-	0.50	Ni	U
24(3030)	3.00	3.00	0.38	-	0.40	Ni	U
48(6060)	6.00	6.00	0.58	-	0.40	Ni	U

Unit: mm

詳細については、当社営業部へ問い合わせ下さい。